AsiaNet 98820

 **Supermicro、高性能、高エネルギー効率（空冷・液冷）システムの幅広いポートフォリオを発表**

**次期 第４世代 インテル(R) Xeon(R)スケーラブル・プロセッサーに対応**

*SuperBlade***(R)***、Hyper、BigTwin***(R)***、GrandTwin(TM)、SuperEdge、FatTwin***(R)***、SXM/OAM/PCIe対応GPUサーバー、CloudDC、WIO、ペタスケールストレージシステムを網羅する、広範なX13ポートフォリオ*

カリフォルニア州サンノゼ, 2022年11月23日 /PRNewswire/ -- **Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI）は、クラウド、AI/ML、HPC、ストレージ、5G/Edge、グリーンコンピューティングをリードする、トータルITソリューションプロバイダーです。同社は、米国で開催されたS**upercomputing Conference 2022において、次世代の 第４世代 インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー（コードネーム：Sapphire Rapids）に対応する、サーバーおよびストレージシステムの、業界で最も広範なポートフォリオを発表しました。

写真 - [https://mma.prnewswire.com/media/1947027/Super\_Micro\_Portfolio.jpg](https://c212.net/c/link/?t=0&l=ja&o=3709449-1&h=2220025024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3709449-1%26h%3D3617512518%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1947027%252FSuper_Micro_Portfolio.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1947027%252FSuper_Micro_Portfolio.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1947027%2FSuper_Micro_Portfolio.jpg)

ロゴ - [https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro\_Logo.jpg](https://c212.net/c/link/?t=0&l=ja&o=3709449-1&h=2039747860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3709449-1%26h%3D2549121197%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)

Supermicroは、最も要求の厳しいAI、クラウド、5Gエッジの様々な要件に対応する最先端でセキュアなシステムを提供し続けるため、Building Block Solutions(R) のアプローチを活用し続けています。この新しいシステムは、性能は最大2倍、最大容量512GBのDIMMの高性能CPUとDDR5メモリー、、I/O帯域幅2倍のPCIe 5.0をサポートしています。また、インテル**(R)** Xeon**(R)** CPU MAXシリーズ（コードネーム：Sapphire Rapids HBM High Bandwidth Memory［HBM］）にも対応し、各種Supermicro X13システムで提供されます。さらに、最大40℃（104° F）の高い周囲温度環境をサポートし、空冷および液冷に対して最適な効率を実現するサーバーは、オープンな業界標準設計と安全性・管理能力の向上によりラック・スケールで最適化されています。

Supermicroの社長兼最高責任者（CEO）であるチャールズ・リアン（Charles Liang）は、次のように述べています。「Supermicroは、インテルの最新テクノロジーに基づく業界で最も広範なシステムポートフォリオを今回もいち早く市場に提供します。SupermicroのトータルITソリューション戦略により、ハードウェア、ソフトウェア、ラック・スケールの検証、および、液冷を含む、完全なソリューションをお客様に提供することが可能になります。当社の革新的なプラットフォーム設計とアーキテクチャは、第４世代 インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー の魅力を最大限に引き出し、最高のパフォーマンス、構成の柔軟性、省電力を実現し、高い性能とエネルギー効率に対する需要の高まりに対応します。このシステムは、Supermicroのラック・スケール生産能力の著しい成長により、従来の３倍のラック容量にも対応するラック・スケールで最適化されています。」

また、様々なワークロードに適合するシステムポートフォリオは、新しい インテル Xeon プロセッサーに内蔵されたアプリケーション最適化アクセラレーターと理想的な組み合わせです。SuperBladeサーバーを含むX13システムポートフォリオは、インテル(R) Advanced Matrix Extensions（インテル(R) AMX）を最大限に利用することで、[特定の](https://c212.net/c/link/?t=0&l=ja&o=3709449-1&h=1229157133&u=https%3A%2F%2Fedc.intel.com%2Fcontent%2Fwww%2Fjp%2Fja%2Fproducts%2Fperformance%2Fbenchmarks%2Fvision-2022%2F&a=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE" \t "_blank)ディープラーニング性能を向上させることができます。BigTwinおよびGrandTwinを用いたクラウドとWebサービスのワークロードは、インテル(R)Data Streaming Accelerator（インテル(R) DSA）を活用してストリーミングデータの移動と変換処理を最適化し、さらに、インテル(R) QuickAssistテクノロジー（インテル(R) QAT）を暗号化アルゴリズムに利用することができます。また、Hyperなどのシステムは、インテル(R) VRAN Boostにより、5Gやエッジの性能を強化し、消費電力を削減することができます。

SupermicroのX13システムポートフォリオは、性能の最適化、優れたエネルギー効率、管理能力・安全性の向上、オープン性、そしてラック・スケールの最適化を実現しています。

**性能の最適化**

・最大性能を引き出す最大700WまでのCPUとGPUに対応。

・最大4800MT/sのDDR5メモリーを搭載し、CPUとのデータ移動を高速化して、処理能力を向上。

・PCIe 5.0をサポートし、周辺機器の帯域幅を倍増させ、ストレージアクセラレーターやハードウェアアクセラレーターとの通信時間を短縮。

・Compute Express Link（CXL 1.1）のサポートにより、アプリケーションによるリソース共有を可能にし、アプリケーションが従来よりもはるかに大きなデータセットを扱うことが可能。

・NVIDIA、AMD、インテルの各種アクセラレーターに幅広く対応し、GPUのAIとメタバースを実現。

・複数の400G InfiniBandと、Data Processing Units（DPU）のサポートにより、極めて低遅延のリアルタイム・コラボレーションを実現。

・インテル(R) Xeon(R) CPU MAX シリーズ（コードネーム：Sapphire Rapids HBM）をサポートし、4倍のメモリー帯域を実現、さらに、インテル(R) データセンター GPU MAX シリーズ（コードネーム：Ponte Vecchio）をサポート。

**優れたエネルギー効率 - データセンターのOPEXを削減**

・最高40℃（104° F）までの高温なデータセンター環境での動作を可能にし、冷却コストを削減。

・空冷、または、ラック・スケールの液冷テクノロジーをサポート。

・CPUとGPUの性能を最大限に引き出すことが可能な、複数のエアフロー冷却ゾーンをサポート。

・自社設計のチタニウムレベル電源により、運用効率が向上。

**安全性と管理性の向上**

・NIST 800-193準拠ハードウェアプラットフォームのRoot of Trust（RoT）を、すべてのサーバーノードに搭載し、セキュアな起動、セキュアなファームウェアアップデート、および、自動復旧を実現。

・業界標準に合わせて設計された、第２世代の Silicon RoTは、コラボレーションとイノベーションの機会を提供。

・サーバーの製造を通したマザーボードの設計製造からお客様に至るまで、オープンな業界標準ベースの認証／サプライチェーンを保証。Supermicroは、署名付き証明書とセキュアなデバイスIDを使用して、各コンポーネントとファームウェアの整合性を暗号で証明。

・ランタイムBMC保護は、継続的に脅威を監視し、通知サービスを提供。

・ハードウェアTPMは、セキュアな環境でのシステム運用に必要な追加機能と測定機能を提供。

・業界標準のセキュアなRedfish APIをベースに構築されたリモート管理により、Supermicro製品を既存のインフラストラクチャにシームレスに統合可能。

・包括的なソフトウェアスイートにより、コアからエッジまで展開するITインフラストラクチャソリューションの大規模なラック管理を実現。

・サードパーティの標準ハードウェアとファームウェアによる、統合、検証済みのソリューションにより、すぐに利用可能な最良の環境をIT管理者に提供。

**オープンな業界標準をサポート**

・E1.Sは、すべてのフォームファクターに共通のコネクタ、幅広い電源プロファイル、改善された熱プロファイルを備え、将来性のあるプラットフォームを提供。

・OCP 3.0準拠のAdvanced IO Module（AIOM）カードは、PCIe 5.0をベースに最大400Gbpsの帯域幅を提供。

・OCP Open Accelerator Module（OAM）Universal Base Board Designに対応。

・オープンなORV2準拠DC電源ラックバスバーに対応。

・一部の製品ではOpen BMCおよび Open BIOS（OCP OSF）をサポート。

**Supermicro X13ポートフォリオには、以下の製品が含まれています。**

**SuperBlade(R)** – Supermicroの高性能、高密度に最適化され、高エネルギー効率のSuperBladeは、多くの企業の初期投資と運用コストを大幅に削減することができます。SuperBladeは、冷却、ネットワーク、電源などの共有・冗長コンポーネントを利用し、出来る限り小さな物理的設置面積で、最大のサーバーラックコンピューティング性能を提供します。このシステムは、AI、データ分析、HPC、クラウド、エンタープライズのワークロード向けに最適化されています。

**PCIe搭載GPUサーバー** – AI、ディープラーニング、HPC、ハイエンドグラフィックスのプロフェッショナル向けに最適化され、最大限の高速化、柔軟性、高性能、バランスの取れたソリューションを提供します。SupermicroのGPU最適化システムは、最先端のアクセラレーターに対応し、劇的な性能向上とコスト削減の両方を実現します。これらのシステムは、HPC、AI/ML、レンダリング、VDIのワークロード向けに設計されています。

**Universal GPUサーバー** – X13 Universal GPUシステムは、標準化されたオープンなモジュラー型GPUサーバーで、デュアルの 第４世代インテル(R) Xeon(R)スケーラブル・プロセッサー を搭載し、ホットスワップ対応のツールレス設計により、優れた性能と保守性を提供します。GPUオプションは、最新のPCIe、OAM、NVIDIA SXMテクノロジーから選択可能です。これらのGPUサーバーは、AIトレーニング、HPC、ビッグデータ分析などの、最も要求の厳しいワークロードに最適です。

**Hyper** – 最も要求の厳しいワークロードを担うために構築されたX13 Hyperシリーズは、Supermicroの様々なラックマウントサーバーに次世代のパフォーマンスをもたらし、広範なアプリケーションのニーズに適応するストレージとI/Oの柔軟性を備えています。

**BigTwin(R)** – X13 BigTwinシステムは、ノードあたり、デュアルの 第４世代 インテル(R) Xeon(R) スケーラブル・プロセッサー を搭載し、ホットスワップ対応のツールレス設計により、優れた密度、性能と保守性を提供します。これらのシステムは、クラウド、ストレージ、メディアワークロードに最適です。

**GrandTwin(TM)** – X13 GrandTwinは、シングルプロセッサーの性能を引き出すために構築された新しいアーキテクチャです。コンピューティング、メモリー、効率を最大化する設計により、最高密度を実現します。シングルの 第４世代 インテル(R) Xeon(R) スケーラブル・プロセッサー を搭載する、GrandTwinの柔軟なモジュラー設計は、必要に応じてコンポーネントを追加または削除できるため、幅広いアプリケーションに容易に適応でき、コストを削減することができます。さらに、Supermicro GrandTwinは、フロントまたはリアのI/Oの構成が選択でき、フロント（コールドアイル）ホットスワップ対応ノードにより保守性を向上します。X13 GrandTwinは、CDN、マルチアクセス・エッジ・コンピューティング、クラウドゲーミング、高可用性キャッシュクラスターなどのワークロードに最適です。

**FatTwin(R)** - X13 FatTwin高密度システムは、８ノードまたは４ノード（各ノードシングルプロセッサー構成）の高度なマルチノード4Uツインアーキテクチャを提供します。フロントアクセスが可能な保守設計により、コールドアイルの保守を可能にし、データセンターのコンピューティングやストレージ密度を最適化する高度な構成を実現するシステムです。さらに、FatTwinは、1ノードあたり最大6ドライブ（8ノード構成）または、最大8ドライブ（4ノード構成）のホットスワップ対応NVMe/SAS/SATAハイブリッドドライブベイをサポートしています。

**Edgeサーバー** – Supermicro X13 Edgeシステムは、通信事業者のエッジワークロード向けに最適化されており、コンパクトなフォームファクターで高密度の処理能力を提供します。ACかDCの選択が可能な柔軟な電源構成と、最大55℃（131°F）までの高い動作温度により、マルチアクセス・エッジ・コンピューティング、Open RAN、屋外設置のエッジ展開に最適です。Supermicro SuperEdgeは、奥行きの短い2Uフォームファクターに、3台のホットスワップ可能なフロントI/Oのシングルプロセッサーノードを搭載し、インテリジェントエッジに高密度コンピューティングと柔軟性を提供します。

**CloudDC** – ２つまたは6つのPCIe 5.0スロット、および、デュアルAIOMスロット（PCIe 5.0、OCP 3.0準拠）を搭載したI/Oとストレージの究極の柔軟性により、最大のデータスループットを実現します。Supermicro X13 CloudDCシステムは、ツールレスのブラケット、ホットスワップ対応ドライブトレイ、冗長電源により、データセンターでの迅速な展開とより効率的なメンテナンスを提供し、保守の利便性を実現するよう設計されています。

**WIO** – Supermicro WIOシステムは、幅広いI/Oオプションを提供し、特定の要件に合わせて最適化されたシステムを実現します。ユーザーは、ストレージとネットワークの選択肢を最適化することで、性能を強化し、効率を高め、アプリケーションに最適な構成を見つけることができます。

**ペタスケールストレージ** – X13オールフラッシュNVMeシステムは、EDSFFドライブによって業界をリードするストレージ密度と性能を提供し、単一の1Uシャーシでこれまでにない容量と性能を実現します。X13ストレージシステムラインナップの最初の製品となるこの最新E1.Sサーバーは、業界をリードするすべてのフラッシュベンダーが提供する9.5mmと15mm両方のEDSFFメディアをサポートします。

**MPサーバー** – X13 MPサーバーは、2U設計で最大の構成の柔軟性とスケーラビリティを実現します。X13マルチプロセッサーシステムは、第４世代 インテル(R) Xeon(R) スケーラブル・プロセッサー に対応し、新しいレベルのコンピューティング性能と柔軟性を提供することで、ミッションクリティカルなエンタープライズ・ワークロードをサポートします。

第4世代インテルXeonスケーラブル・プロセッサーを搭載したSupermicroサーバーの詳細については、[www.supermicro.com/x13](https://c212.net/c/link/?t=0&l=ja&o=3709449-1&h=521415638&u=http%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fx13&a=www.supermicro.com%2Fx13) をご覧ください。

特定のお客様には、Supermicro X13サーバーへの早期リモートアクセスが可能な、Supermicro X13 JumpStartプログラムを提供しており、第4世代 インテル Xeon スケーラブル・プロセッサーをベースとした最新のSupermicro X13システムによるアプリケーションテストが可能です。詳細については、[www.supermicro.com/jumpstart/x13](https://c212.net/c/link/?t=0&l=ja&o=3709449-1&h=2465971352&u=http%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fjumpstart%2Fx13&a=www.supermicro.com%2Fjumpstart%2Fx13) をご覧ください。

**Supermicro（Super Micro Computer, Inc.）について**

Supermicro（NASDAQ: SMCI）は、アプリケーションに最適化したハードウェアとトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャー市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、サービスを提供する、トータルITソリューションプロバイダーとして常に変革をもたらすことに注力し、様々な種類のマザーボード、シャーシ、電源に至る製品を、自社で設計、製造し、提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、台湾、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions(R)は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式（空冷や液冷）の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、We Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標または登録商標です。

Intel、Intelロゴ、その他Intelのマークは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

他のすべてのブランド、名称、商標は、それぞれの所有者に帰属します。

報道関係者お問合せ先  : Super Micro Computer Inc. 国内広報代理, ホフマンジャパン株式会社, 担当: 小嶋 / 橋本, Email: supermicrojp@hoffman.com

（日本語リリース：クライアント提供）